

# 「BTレジン」の発明と実用化

## ～今日の故障をしない電子機器の生みの親～

「BTレジン」は三菱瓦斯化学で発明された新しい耐熱性付加重合型熱硬化性樹脂です。ユニークな実用性の高い高性能材料であり、この特性が国内外に於いて高く評価され、電子機器用プリント配線材料、航空機用構造材料、重電機器用絶縁材料、特にプリント配線材料は世界中で携帯電話用配線材料など広範囲な分野で実用化が進められています。このBTレジンの生みの親である講師に開発に至った経緯や、その気概はどこから生まれてきたのか、ものづくりの発想力や源などについて語っていただきます。この機会に是非ご聴講くださいますようお願いいたします。

### 【講師】工学博士・技術士 綾野 怜 氏

<プロフィール> 1932年横浜市神奈川区に生まれる。日本大学工学部卒業。  
 1958年 北辰化学工業(株)にて防衛庁向けVT信管用電源積層電池完成。  
 1959年 北辰化学工業(株)より独・バイエル社にポリウレタン技術導入で派遣。  
 1962年 ドイツプラスチック研究所研究員。リビングポリマーの研究を行う。  
 1963年 東京大学宇宙航空研究所(現:先端科学技術研究センター)に留学。  
 1972年 BTレジン(耐熱性樹脂)の研究を始める。  
 1979年 三菱ガス化学(株)電子材料事業部BT班初代班長就任。  
 1987年 愛敬油化(株)代表理事副社長就任。(日韓合弁会社)  
 1987年 日本フタリック工業(株)代表取締役社長就任。  
 1998年 大阪経済法科大学アジア研究所客員研究員。



■日 時: 平成27年3月23日(月)セミナー: 午後3時～4時30分(受付: 午後2時30分～)

交流会: 午後4時40分～5時40分

■場 所: 川崎フロンティアビル2階 KCCI ホール第3会議室(川崎市川崎区駅前本町11-2)

■定 員: 50名(先着順)

■会 費: セミナーのみ 会員無料 (非会員2,000円)  
 交流会参加費 2,000円 ※当日受付にて受領いたします。

■申込方法: 下記の参加申込書にご記入の上、本チラシ全文をFAXしてください。

メールでのお申込みは、セミナー名と下記必要事項をご記入の上、申込先アドレスにご送信ください。

■申込・お問合わせ先: 川崎商工会議所 幸支所

(TEL 044-555-0301 ・ FAX 044-555-0368 ・ E-mail:saiwai@kawasaki-cci.or.jp)

★受講票は発行いたしませんので、直接会場にお越しください。

★参加お申し込みされた方で、企業・商品パンフ、イベント案内、PRチラシなど当日配布を希望される資料等がございましたら、上記問合わせ先にお申し出ください。

(個人情報取扱について)

お申し込みいただいた情報は、当所からの各種連絡・情報提供に利用する他、参加者名簿として講師に提供する場合があります。

事業所名		参加者氏名	
所在地			
TEL	FAX		

○印をお付け下さい 会員 ・ 非会員 / 交流会 参加 ・ 不参加